

深圳佰维存储科技股份有限公司

投资者关系活动记录汇总表

(2026 年 9 月 16 日、9 月 17 日、9 月 24 日)

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐专场机构交流会 ☐现场参观 ☐其他 _____
参与单位名称及人员姓名	UG INVESTMENT Kevin Yang、UG INVESTMENT Sharon Chen、Samsung Asset Management Shim Juhyun、Infinity Global Asset Management Shin Hyun-tae、DS Asset Management Hong Seong-ho、Corsa Asset Ko Yun Young、KB Asset Management Shim Hyo Sub、Life Asset Management Kim Taesik、Hana Securities Oh Won Seok、Hana Securities Lee Sang Myung、Hana Securities Kim Kyung Hwan、Hana Securities Baek Seung-hye、Kiwoom Asset Management Lee Ji Ho、博时国际 Park JaeKyun、博时国际 Park Taejin、博时国际 肖骁、中泰证券 王峙博、Capital International Archana Basi、Capital International Akira Shiraishi、Capital International Arthur Caye、Capital International Eric Tse、Capital International Gerald Du Manoir、Capital International Lisa Thompson、Capital International Liying Du、Capital International Qiuwei Lin、Capital International William Pang、Capital International Yang Yang
会议时间	2026 年 9 月 16 日 16:00-17:00 2026 年 9 月 17 日 14:00-15:30 2026 年 9 月 24 日 10:45-11:45
会议地点	佰维存储三楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司管理层 董办工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	Q1. 公司 AI 新兴端侧存储产品上半年收入约 28.6 亿元，同比增长 433.58%，该业务收入大幅提升的原因有哪些？ A1: 公司在智能穿戴等 AI 新兴端侧领域深耕多年，构建了差异化的竞争优势，公司 ePOP 等代表性存储产品具有低功耗、快响应、轻薄小巧等优势，产品表现出色，目前已被 Meta、Google、阿里、小米、小天才、Rokid、雷鸟创新等国内外知名企业应用于其 AI/AR 眼镜、智能手表等智能穿戴设备上。 Q2. 公司车规存储业务的客户进展、海外突破及新产品验证情况如何？ A2: 在智能汽车领域，公司已实现车规级存储产品的批量交付和规模销售，累计导入国内外 40 余家主流主机厂及核心 Tier1 供应商的供应链；其中，海外市场取得突破，已进入海外多家主流 Tier1 供应商的供应链体系；产品方面，公司正加速推进 UFS、BGA SSD 等新一代高带宽、大容量车规级存储产品的导入与上车验证，以满足智能座舱、自动驾驶等复杂应用场景对高性能存储的迫切需求；

	此外，依托自研主控技术，公司可提供全栈国产化、安全可靠的车规级存储解决方案。 Q3. 公司位于东莞的晶圆级先进封测制造项目构建了哪些技术平台？相关产品研发进展如何？ A3：公司晶圆级先进封测制造项目目标打造“存、算、运”综合服务平台，正在开发多种存算合封技术方案、先进存储芯片技术方案和光电互联方案，覆盖了 2.5D、RDL、Fan-in、Fan-out 等多种先进封装形式。公司创新的垂直引线键合及晶圆级扇出工艺，能够大幅缩小整体封装尺寸，并支持大带宽定制化方案。在产品进展方面，公司已推出使用 FOMS-R（扇出型存储堆叠）工艺的超薄 LPDDR 产品，满足 AI 时代大容量、高密度存储需求，该产品进展顺利，目前已经收到客户需求预测；公司 CMC（存算芯粒）产品实现 10 颗 Chiplet 集成封装，目前已完成工艺开发样品制作；公司 OEC（光电共封装）产品目前正在与客户合作开发 6.4T NPO 的光引擎封装，预计 2026 年第四季度完成研发。 Q4. 当前存储行业价格走势如何？公司对行业趋势如何判断？ A4：根据 Trend Force 集邦咨询数据，2026 年第三季度一般性 DRAM 合约价预计增长 13-18%，NAND Flash 合约价预计增长 10-15%。目前不同品类价格走势分化，部分品类持续上涨，部分持平。本轮存储涨价由 AI 算力需求爆发引起，公司将持续跟踪未来存储行业的发展趋势。 Q5. 能否介绍公司适配 AI 端侧、边缘、云端场景的存储产品布局，以及先进封测业务对 AI 产业需求的配套支撑能力？ A5：公司紧抓 AI 发展浪潮，针对端侧、边缘端和云端推理等不同应用场景，构建了全面的存储解决方案体系。在端侧应用领域，公司面向 AI 手机、AI PC 及智能可穿戴设备等新兴终端，推出 LPDDR5X、DDR5、UFS、PCIe 5.0 SSD 及 ePOP 等存储产品，全面满足终端设备在高速读写、能效优化、小型化与轻薄化等方面的严苛要求。在边缘计算场景，公司依托 LPDDR、eMMC、UFS 及车规级存储产品组合，提供高可靠性、高带宽、低延迟的解决方案，有效支撑 AI 边缘设备对实时数据处理与高能效比的迫切需求。在云端推理与数据中心领域，公司积极布局 RDIMM、PCIe SSD、SATA SSD 及 CXL DRAM 模组等产品，为服务器和 AI 基础设施提供高吞吐、高密度、低功耗的存储产品支持，助力应对日益增长的密集型 AI 工作负载。此外，公司通过晶圆级先进封测制造项目服务于先进存储器、存储与计算整合以及光电共封装等领域，满足 AI 时代“存、算、运”的需求。
附件清单	无
日期	2026 年 9 月 16 日、9 月 17 日、9 月 24 日
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。